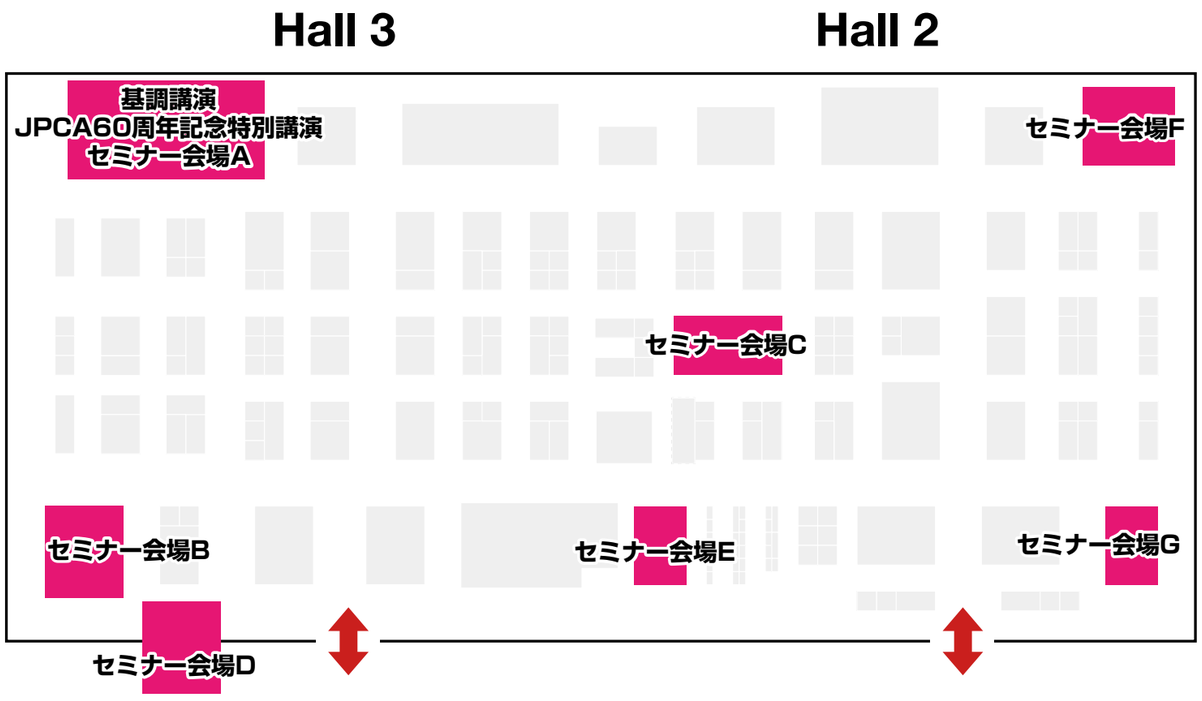
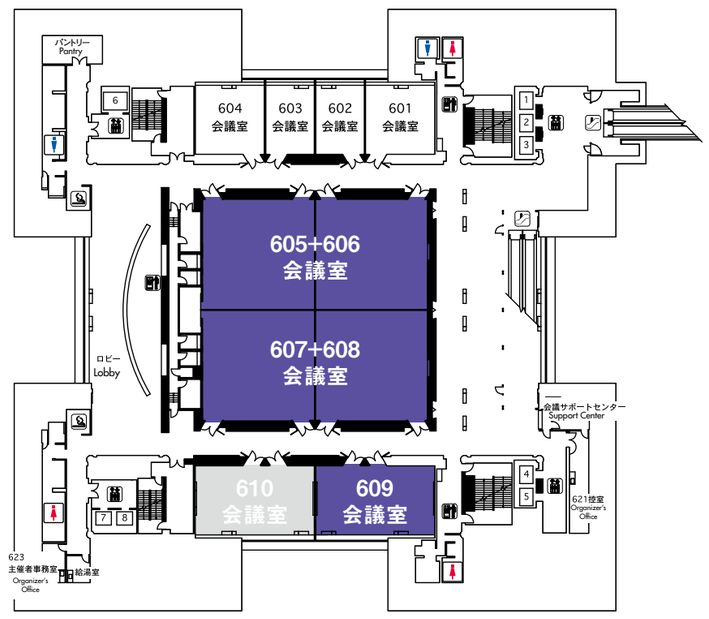
カンファレンスマップ

JPCA Show 2023 第52回国際電子回路産業展 / JIEP マイクロエレクトロニクスショー 第37回 最先端実装技術・パッケージング展 / JISSO PROTEC 2023 第24回 実装プロセステクノロジー展 / SDGsデバイス展 / WIRE Japan Show 電気・光伝送技術展 / Electronics Component & Unit Show / E-Textile/Wearable イーテキスタイル／ウェアラブル展 / Smart Sensing スマートセンシング / 無人化ソリューション展 / Edge Computing エッジコンピューティング / interopto インターオプト / Imaging Japan イメージングジャパン

展示ホール内セミナー会場案内図



会議棟セミナー会場案内図



会議棟6F

電子機器トータルソリューション展　基調講演（JPCA創立60周年記念） 有料 VIP/会員無料 要事前登録　セミナー会場A

聴講料：会員・VIP 無料、非会員 20,000円／1セッション（聴講料は税込です）　※JPCA会員／JIEP正会員・賛助会員・学生会員／JARA正会員・賛助法人会員／JEP・TEP会員

	5月31日（水）	6月1日（木）	6月2日（金）
10:45〜11:30	SDGs電子デバイス メタバースとSDGsで高成長を狙う! 〜ニッポン及び世界の半導体の大型プロジェクトに注目〜 泉谷 渉　㈱産業タイムズ社　代表取締役会長	自動車 すべての人に移動の自由を -トヨタの自動運転技術開発の取組み- 鯉渕 健　トヨタ自動車㈱　コネクティッドカンパニー　ビジネス領域　統括部長/フェロー	半導体の未来 半導体、半導体製造装置　その未来と課題 寺本 章伸　広島大学　ナノデバイス研究所　所長・教授
11:45〜12:30	半導体/パッケージ 半導体・デジタル産業戦略の現状と今後 荻野 洋平　経済産業省　商務情報政策局 デバイス・半導体戦略室　室長	ロボット・自動化 製造業が直面する労働力問題と電子業界への自動化の提案 〜製造現場に導入しやすい自動化を目指して〜 山口 賢治　ファナック㈱　代表取締役社長 兼 CEO　(一社)日本ロボット工業会　会長	日本の半導体戦略 日本の半導体戦略 〜More Moore, More than Moore, More People〜 黒田 忠広　東京大学　大学院工学系研究科附属 システムデザイン研究センター　教授
13:30〜14:15	SiCパワー半導体 脱炭素社会の実現に向け、ますます重要となるパワー半導体とアナログ技術 松本 功　ローム㈱　代表取締役社長　社長執行役員 CEO	無人化/IoT 変える力とつなぐ力でIoT実装に革命を 平田 勝則　コネクテックジャパン㈱　代表取締役社長	ウェアラブル/E-Textile ウェアラブルデバイスが切り拓く 人間とコンピュータの新たな関係 〜医療・健康・教育・エンタテインメント〜 寺田 努　神戸大学　大学院工学研究科　教授

JPCA創立60周年記念特別講演 プログラム 無料 要事前登録　セミナー会場A

	5月31日（水）	6月1日（木）	6月2日（金）
14:30〜15:30	電子機器の歴史/展望 エレクトロニクス産業とイノベーションの波 日本は捨てたもんじゃない 片山 幹雄　東京大学　生産技術研究所　研究顧問／㈱Kconcept　代表取締役社長（元シャープ社長）	空飛ぶ自動車 空飛ぶクルマ時代のビジネスについて 浅井 尚　エアモビリティ㈱　代表取締役社長&CEO	半導体/実装技術 新たな世界的半導体イノベーション時代の幕開け 小池 淳義　Rapidus㈱　代表取締役社長

ダントツものづくりセミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場C

	5月31日（水）	6月1日（木）	6月2日（金）
	リーンなものづくりセッション	危機対応ものづくり / 6Σ的経営 / DXセッション	ROA / 管理会計セッション
13:00-13:45	【特別講演1】飛躍的な生産性を実現する 全体最適の働き方イノベーション 岸良 裕司　ゴールドラット・ジャパン　CEO	【特別講演3】危機対応で進化する グローバルサプライチェーンとものづくり 新宅 純二郎　東京大学　大学院経済学研究科　教授　経済学博士	【特別講演4】トヨタ式現場管理 田中 正知　トヨタ自動車OB　ものつくり大学　名誉教授/J-コスト研究所　代表
13:45-14:30	【特別講演2】月曜日が楽しみな会社にしよう! 〜全体最適のマネジメント理論TOCとは〜 岸良 裕司　ゴールドラット・ジャパン　CEO	品質経営の取り組み方（シックスシグマ品質） アイリス リュウ　マイクロンメモリジャパン㈱ カスタマークオリティエクスペリエンス シニアマネージャー　工学博士	【特別講演5】現場改善のJコスト理論による 強化策（ROA） 田中 正知　トヨタ自動車OB　ものつくり大学　名誉教授/J-コスト研究所　代表
14:35-15:35	コロナ2019禍のトヨタ式改善事例 ー標準のないところにカイゼンはないー 濱松 史郎　トヨタ自動車OB　カイゼンコンサルタントサービス　代表	製造業DXを実現 GD.findi -未来を予測し、最適解を導く、唯一のDX技術- 大橋 輝雄　㈱レクサー・リサーチ　GSCグループ　グループリーダー	【特別講演6】経営者に見える現場改善効果 「現場改善会計（GKC）」 柊 紫乃　愛知工業大学　経営学部経営学科　教授 博士（経営情報科学）
15:40-16:25	JPCAものづくり大賞準大賞受賞 改善取組み事例報告3件 2018年度 ㈱愛工機器製作所コア加工事業部 2019年度 板橋精機㈱岩間工場 2020年度 FICT㈱製造本部	JPCAものづくり大賞準大賞受賞 改善取組み事例報告3件 2020年度 ㈱アスコーテック新潟工場 2021年度 ㈱メイコー福島工場 2021年度 太陽インキ製造㈱北九州事業所/埼玉工場	16:15-17:00
			【総括基調講演】経営効果がわかる、トヨタ生産システム 山本 治彦　JPCAものづくりアカデミー　校長

JIEPアカデミックプラザ 無料 事前登録不要　セミナー会場E

	5月31日（水）	6月1日（木）	6月2日（金）
13:00-13:20	深層学習を用いた動物認識システムにおける使用モデルの検討　長野工業高等専門学校	非懸濁浴からの第4級アンモニウム塩を用いた亜鉛-酸化チタン複合めっき膜の作製　関東学院大学大学院	聴覚障害者のための深層学習を用いた警告音可視化システムの開発　長野工業高等専門学校
13:20-13:40	セルロースナノファイバを用いた破れない金箔の開発と今後の展開　大阪公立大学	紫外線照射を用いた平滑樹脂への無電解Ni-P薄膜の選択析出　関東学院大学大学院	非歩行下でも発汗量計測可能なヘルメット型デバイスの開発　諏訪東京理科大学
13:40-14:00	デジタルツインを目指した高速度ビデオモニタ画像診断のCuダイレクトレーザビアホール加工への適用　同志社大学大学院	非水溶媒浴からのアルミニウム電析への第四級アンモニウム塩微量添加効果　関東学院大学大学院	光プローブ電流センサの高感度化のための小型集磁ヨークの検討　信州大学
14:00-14:20	マイクロドリル工具のカタログマイニングに基づく加工条件に対する高度な新知識発見　同志社大学大学院	3次元実装ICへの遅延故障検査容易化バウンダリスキャン設計の適用　徳島大学大学院	GHz帯薄膜コモンモードフィルタの広帯域化と低群遅延特性の両立　信州大学
14:20-14:40	ロータス金属が引き起こすブリージング現象を利用した空冷および沸騰浸漬冷却技術　山陽小野田市立山口東京理科大学	遅延故障検査容易化バウンダリスキャン設計のFPGAへの実装に関する検討　徳島大学大学院	人体通信と電波通信における人体周囲につくられる電磁界分布の検討　東京工芸大学大学院
15:00-15:20	IoTデバイスの継続的な発電に向けた小型有機ランキンサイクル発電システムの開発　日本大学	結晶構造を制御した銅ナノ粒子を用いる高強度銅接合材料の設計と構築　北海道大学	腕部上に配置する通信用スパイラルコイルの位置ずれに対する伝送特性と磁界分布の検討　東京工芸大学
15:20-15:40	ハーネスレスを目的とした電源内蔵型MEMSマイクロロボットの検討　日本大学	テンプレートストリッピングによる接合面の平滑化　東北大学	ハイパーサーミア用肝臓等価ファントムの試作　東京理科大学
15:40-16:00	歩容と歩行周期が同時に変化する人型筋骨格ロボット用ハードウェアCPGモデルの開発　日本大学	化学因子による銀系導電性接着剤の焼結挙動制御と金属電極に対する接着界面特性の向上　群馬大学大学院	電源ケーブルの撚れとコモンモード電流の関係　東京理科大学
16:00-16:20	歩行と走行を切り替える2足歩行制御用ハードウェアCPGモデルアナログICチップの検討　日本大学	銅系導電性ペーストの電気伝導特性と電気的信頼性に影響を及ぼす界面現象解析　群馬大学大学院	交流磁界が実験用小動物に与える影響とその生理的意義の調査　東京理科大学
16:20-16:40	動物の神経系を模倣したニューロモーフィック回路を実装した自律ロボットシステムの開発　日本大学大学院	ストレッチャブル印刷配線の機械的および電気的挙動解析と配線構造設計に向けた検討　群馬大学大学院	埋込み型運動量計への無線給電と情報伝送の両立の検討　東京理科大学
16:40-17:00	表彰式	セルロースナノファイバの化学修飾およびセンサ応用に関する研究　山形県工業技術センター	

3D-MIDパビリオンセミナー 無料　セミナー会場E

	5月31日（水）
10:15-10:45	MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦　日本MID協会　幹事
11:00-11:30	JEITA 実装用MIDテクニカルレポートPG活動紹介 坂本 一三　電子情報技術産業協会（JEITA）　電子実装技術標準化専門委員会　主査
11:45-12:15	3D-MIDのためのエレメカ協調設計環境 松澤 浩彦　㈱図研　技術本部EL開発部　シニア・パートナー

	6月1日（木）
10:15-10:45	3D-MIDのためのエレメカ協調設計環境 松澤 浩彦　㈱図研　技術本部EL開発部　シニア・パートナー
11:00-11:30	実装の最後の要「IHリフロー」で3D-MIDの社会実装を実現 岡庭 年春　㈱ワンダーフューチャーコーポレーション　営業部　取締役営業部長
11:45-12:15	分子接合技術による高周波伝送対応MIDの開発 目黒 和幸　（地独）岩手県工業技術センター　機能材料技術部　上席専門研究員

	6月2日（金）
10:15-10:45	MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 浩彦　日本MID協会　幹事
11:00-11:30	分子接合技術による高周波伝送対応MIDの開発 目黒 和幸　（地独）岩手県工業技術センター　機能材料技術部　上席専門研究員
11:45-12:15	実装の最後の要「IHリフロー」で3D-MIDの社会実装を実現 岡庭 年春　㈱ワンダーフューチャーコーポレーション　営業部　取締役営業部長

製品安全セミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場F

	6月1日（木）
13:30-14:30	プリント配線板の製品安全セミナー 榧場 正男　㈱カヤバオフィス　代表取締役

熱関連セミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場B

	6月1日（木）
13:30-14:30	JPCA熱関連セミナー 鈴木 康一　山口東京理科大学　名誉教授／畠山 友行　富山県立大学　准教授
14:30-15:30	「高放熱ヒートスプレッダ、ダイヤモンドフィラー分散銅鍍金被膜」について 別所 毅　トヨタ自動車㈱　モビリティ材料技術部　車両材料開発室　プロフェッショナル・パートナー

車載電子機器向け電子回路基板規格書ガイドラインセミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場C

	5月31日（水）	6月1日（木）	6月2日（金）
10:30-11:15	車載電子機器向け電子回路基板規格書ガイドラインセミナー 浦西 泰弘　JPCA高信頼性車載用電子回路評価基準WG　幹事		

経済安全保障セミナー 無料 要事前登録　セミナー会場D

	6月1日（木）
13:00-14:30	経済安全保障の確保に向けて 〜技術・データ・製品等の流出防止〜 原塚 勝洋　公安調査庁　調査第二部第一課　国際調査企画官

出展者（NPI）プレゼンテーション 無料　セミナー会場G

5月31日（水）	10:15-10:35	外注に頼らないPCB基板作製、フレキシブル・エレクトロニクスのプロトタイプの基板試作 電子回路プリンタ V-ONE / NOVA　テクノアルファ㈱
	10:55-11:15	小型電子部品の筐体接着、防水・防塵シーリング処理、潤滑剤塗布を精密ホットメルトディスペンサで実現！　ノードソン㈱
	11:35-11:55	表面改質の新技術をご紹介！（コーティング剤不要の撥液処理による液滴精度の向上、ガス不要の還元処理）　㈱魁半導体
6月1日（木）	10:15-10:35	エリアレーザーリフローの新情報と課題とその解決方法について ＊エリアレーザーリフローのこれまでの進化と今後の可能性について説明します。　テクノアルファ㈱
	10:55-11:15	ウシオ電機の露光装置とエキシマ照射装置　ウシオ電機㈱
	11:35-11:55	基板及び電子部品加工向けレーザ加工機のご紹介　澁谷工業㈱
	12:15-12:35	VPSリフローと一般的なリフロー装置との比較検討　テクノアルファ㈱
	12:55-13:15	CAD/CAMデータを活用したデータダイレクトソリューション　ダイナトロン㈱
	13:35-13:55	新フィルム状塗布システムの誕生　Shimada Appli（合）
	14:15-14:35	プリント基板露光技術について　㈱ブイ・テクノロジー
	14:55-15:15	BGA実装基板検査の課題を解決するJTAGバウンダリスキャンテストのご紹介　アンドールシステムサポート㈱
	15:35-15:55	インクジェット塗布技術紹介　㈱石井表記
6月2日（金）	10:15-10:35	パワー半導体向け3Dプレス技術とシンタリング（焼結）装置開発のご紹介　日機装㈱
	10:55-11:15	いよいよ量産へ本格導入！ Φ3umの超微細ビア加工を実現したエキシマレーザー加工装置の紹介。　㈱オーク製作所
	11:35-11:55	素材の特性を見える化する！エレクトロニクス材料の熱分析と粘弾性測定　ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン㈱
	12:15-12:35	エレメカ融合EMC検証ツール「3D EMC Adviser」のご紹介　㈱図研
	12:55-13:15	電子部品・半導体製造工程でのDLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティング活用事例。5G通信帯域で使用可能な低誘電DLCなど、各種機能性DLCの紹介。　㈱プラズマイオンアシスト
	13:35-13:55	カーボンニュートラル、低応力接合に対応可能な各種低温硬化型接着材料およびはんだペーストの紹介　日邦産業㈱
	14:15-14:35	プリント基板設計AI自動配置ソリューションのご紹介　㈱オンテック
	14:55-15:15	新製品 マグレブポンプ MJ-100のご紹介　㈱イワキ
	15:35-15:55	新たなユーザーエクスペリエンスの提供 〜新型蛍光X線膜厚計FT230による各種金属膜の測定〜　㈱日立ハイテクサイエンス

PWBコンサルタントスキルアップセミナー 無料 要事前登録 会議棟6階 609会議室

	6月2日（金）
15:00-16:45	PWBコンサルタントスキルアップセミナー 対象 PWBコンサルタント、PWBインストラクタ1級・準1級資格保有者の方のみ 安井 博文　安井事務所　PWBコンサルタント

JIEP最先端実装技術シンポジウム 有料 要事前登録　会議棟6F ＜A会場＞605+606 ＜B会場＞607+608

聴講するには事前登録のうえ、聴講料の支払いが必要です（VIP登録された場合も有料です）。会員区分によって聴講料が異なります。詳細・登録はHPよりご確認ください。www.jpcashow.com/show2023/
「※」マークがついている講演資料は講演データ（有料）に含まれません。

		A会場	B会場
5月31日（水）	Title	31A-1 9:45-12:30	31B-1 9:45-12:30
	Time	高度化するMEMS,センサーデバイス技術最前線　座長：土門 孝彰、西田 秀行	5G/6G高周波材料　座長：松本 博文、高野 希
	9:45-10:40	31A1-1 ロボットが繊細な力感覚作業を行う社会を支える 小型・軽量力覚センサ（仮題）〜MEMS＋金属構造体のハイブリッド実装による商品化〜 井上 匡志　MMIセミコンダクター㈱　MEMS開発部　技術専門職	31B1-1 5G/6Gに向けた高速・高周波用途向け基板材料の技術開発動向※ 広川 祐樹　パナソニック インダストリー㈱ 電子材料事業部　電子基材BU商品開発部　開発一課　課長
	10:40-11:35	31A1-2 自動運転に向けたLIDAR技術の基礎と最新開発状況 高橋 昌幸　ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱　車載事業部・車載設計部　統括部長	31B1-2 5G/6Gを見据えた高周波対応材料の技術・開発動向 森野 正行　AGC㈱　化学品カンパニー 企画部 材料開発室　室長
	11:35-12:30	31A1-3 住友精密工業のMEMS事業について 〜高度500kmから地下4000mまで精密に測定する〜 田中 洋　住友精密工業㈱　MEMS事業室　事業室長	31B1-3 低伝送損失基板を実現する低誘電・高接着ポリイミド樹脂「PIAD」 田﨑 崇司　荒川化学工業㈱　研究開発本部 ファイン・エレクトロニクス開発部 PIグループ　グループリーダー
	Title	31A-2 13:35-16:20	31B-2 13:35-16:20
	Time	自動運転システムとセンシングの最新動向　座長：三宅 敏広、齊藤 雅之	メタバース時代への半導体進化　座長：西田 秀行、土門 孝彰
	13:35-14:30	31A2-1 ステレオカメラの認識技術とその応用 渡邊 龍人　㈱ZMP　ロボテク開発部　チーフエンジニア	31B2-1 IOWN構想を支える光電融合実装技術（仮） 石井 雄三　日本電信電話㈱　NTTデバイスイノベーションセンタ　プロジェクトマネージャー
	14:30-15:25	31A2-2 自動運転を構成する技術 クライソン トロンナムチャイ　神奈川工科大学　創造工学部 自動車システム開発工学科　教授	31B2-2 企業にとってのメタバースとは（仮） 倉島 菜つ美　日本アイ・ビー・エム㈱　IBMコンサルティング事業本部 インタラクティブ・エクスペリエンス事業部　技術理事　インタラクティブ・エクスペリエンス事業部　CTO
	15:25-16:20	31A2-3 自動運転のためのLiDAR技術 伊東 敏夫　芝浦工業大学　システム理工学部　機械制御システム学科　教授	31B2-3 2023〜24年の電子機器と半導体市場展望 南川 明　インフォーマインテリジェンス（合）　コンサルティング　シニアコンサルティングディレクター
6月1日（木）	Title	01A-1 9:45-12:30	01B-1 9:45-12:30
	Time	光電回路技術と半導体の役割　座長：高武 直弘、谷 元昭	情報爆発の救世主、真の省エネを具現化するパワー半導体！　座長：土門 孝彰、渡邊 裕彦
	9:45-10:40	01A1-1 クラウドデータセンター光ネットワークの動向と展開 高井 厚志　LitAhead Consultant　光技術コンサルタント	01B1-1 低炭素社会に貢献できる　パワーデバイス・モジュール技術（仮）※ 多留谷 政良　三菱電機㈱　パワーデバイス製作所　主管技師長
	10:40-11:35	01A1-2 シリコンフォトニクスを用いた光電コパッケージ用パッケージ基板の研究開発 中村 文　（国研）産業技術総合研究所　プラットフォームフォトニクス研究センター　研究員	01B1-2 次世代パワー半導体が貢献する“カーボンニュートラル” 山口 雄平　ローム㈱　LSI事業本部　パワーステージ商品開発部
	11:35-12:30	01A1-3 光回路と「光を用いて計算する」コンピューティング技術※ 橋本俊和　日本電信電話㈱　NTT先端集積デバイス研究所　上席特別研究員	01B1-3 GaO®パワーデバイス&独自パワーモジュールの社会実装を実現するグローバル・オンリーワン企業 井川 拓人　㈱FLOSFIA　営業部　エヴァンジェリスト　共同創業者
	Title	01A-2 13:35-16:20	01B-2 13:35-16:20
	Time	自動車の電動化・パワーエレクトロニクスの動向と実装技術　座長：三宅 敏広、齊藤 雅之	『半導体の進化を支える、日本の基板技術』ー HPC対応半導体/3D-IC/Chip-letに求められる配線基板とは、、、、ー　座長：西田 秀行、猪川 幸司
	13:35-14:30	01A2-1 自動車の脱炭素化/EV化の最新動向と関連製品（e-Axleや車載電池等）の今後の展望 加藤 克司　K&Kテクノリサーチ　代表	01B2-1 先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 規貴　新光電気工業㈱　開発統括部　主席部長
	14:30-15:25	01A2-2 自動車用パワーエレクトロニクスの最新動向 森本 雅之　モリモトラボ　代表	01B2-2 先端パッケージ・サブストレートを支えるコア基材の最新動向 尾瀬 昌久　㈱レゾナック　エレクトロニクス事業本部　開発センター　積層材料開発部　部長
	15:25-16:20	01A2-3 （仮）車載用パワー半導体モジュールのパッケージ技術 池田 良成　富士電機㈱ 半導体事業本部　開発統括部　パッケージ開発部　先行開発課　課長	01B2-3 半導体基板（FCBGA）の需要供給状況と今後の見通し 亀和田 忠司　AZ Supply Chain Solutions　ビジネスコンサルティング　オーナー
6月2日（金）	Title	02A-1 9:45-12:30	02B-1 9:45-12:30
	Time	AR/VR　AI（仮想空間にリアルの世界を作り出す日本の底力）を牽引する実装技術　座長：土門 孝彰、池田 浩昭	『日の丸半導体復活、実現の鍵は、、、？』ー Rapidus/LSTC, IBM, i-Mecが描くシナリオ ー　座長：西田 秀行、和嶋 元世
	9:45-10:40	02A1-1 先端実装の装置技術 奥園 博和　東レエンジニアリング㈱ メカトロファインテック事業本部　第一事業部　営業部　部長	02B1-1 日本半導体産業復活のシナリオ、Rapidus/LSTCの取り組みとこれから（仮） 榎本 貴男　Rapidus㈱　3Dパッケージ部　ディレクター
	10:40-11:35	02A1-2 マイクロエレクトロニクス実装材　最新技術動向 大関 裕樹　デクセリアルズ㈱　コネクティングマテリアル事業部　商品開発部　統括課長	02B1-2 LSTCの先端半導体3Dパッケージングへの挑戦 菅沼 克昭　大阪大学　フレキシブル3D実装協働研究所　所長・特任教授
	11:35-12:30	02A1-3 半導体設備のAR/VR、AIの採用動向※ 横森 憲敬　東京エレクトロン㈱　Corporate Innovation本部　副本部長 東京エレクトロン宮城㈱　執行役員　先端技術開発本部　DX推進担当	02B1-3 ニッポン半導体の再生における実装技術の重要性、最後で最大の機会を活かせ 若林 秀樹　東京理科大大学院　経営学研究科　技術経営専攻（MOT）　教授
	Title	02A-2 13:35-16:20	02B-2 13:35-16:20
	Time	ロードマップセッション　座長：本多 進、猪川 幸司	『Moore則継続への挑戦、3D-IC/Chipletの現状とこれから』ー 前工程と後工程の融合、3DIC Monolithic の実現は、、、、ー　座長：高野 希、谷 元昭
	13:35-14:30	02A2-1 電子デバイス実装技術のロードマップ ・第一部：CPS（Cyber-Physical System）の進展に向けて多様化が加速する電子デバイスパッケージ ・第二部：実装技術の未踏領域への挑戦（バイオセンサー） 杉崎 吉昭　㈱東芝　研究開発センター　先端デバイス研究所 バックエンドデバイス技術ラボラトリー	02B2-1 レゾナックの次世代半導体パッケージに向けた取り組みとJOINT2進捗（仮） 畠山 恵一　㈱レゾナック　エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューションセンター　センター長
	14:30-15:25	02A2-2 JEITA・電子部品技術ロードマップ ーチップ部品、センサー部品を中心にー 槻田 栄　NPO法人サーキットネットワーク　理事長	02B2-2 AI/ML時代を切り拓くウェーハ接合技術※ 山本 宏　イーヴィグループジャパン㈱　代表取締役
	15:25-16:20	02A2-3 100 Tb/s超スループットの実現に向けた光回路実装形態の予測と課題（仮）※ 竹崎 元人　㈱白山　経営管理本部　IOWN推進部　部長	02B2-3 パネルレベルファンアウトFOLP®ならびにチップレット集積化 Die-to-Die Pillar-Suspended Bridge（PSB）技術について 河野 一郎　アオイ電子㈱　FOLP事業部　FOLP/AA課　課長

【JEITA】半導体パッケージングセミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場B

	6月1日（木）
11:30-12:15	次世代プリント配線板製造を見据えたフッ素系樹脂への直接接着・めっき技術 小林 靖之　（地独）大阪産業技術研究所森之宮センター　電子材料研究部 総括研究員　表面工学研究室長

	6月2日（金）
13:30-14:15	高密度配線パッケージの異物不良対策　〜サブミクロン異物の除去技術〜 篠原 友美　㈱ブルックスジャパン　代表取締役
14:30-15:15	Wafer-Level Packagingでのガラス素材の可能性 上舘 寛之　LPKF Laser & Electronics㈱　セールスディレクター

E-Textile/Wearableセミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場B

	5月31日（水）
14:00-16:00	E-Textileアプリケーション策定に向けたワイガヤ座談会進捗報告セミナー 才脇 直樹　奈良国立大学機構　奈良カレッジス連携推進センター　教授・センター長 / 大阪大学　大学院基礎工学研究科　特任教授

E-Textile/Wearable実装技術セミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場B

	6月1日（木）
15:45-16:30	JOHNAN㈱が取り組む機能性フィルム実装開発（ストレッチャブル実装、紙実装その他） 松田 良成　コムスキャンテクノ㈱　代表取締役 / JOHNAN㈱　執行役員

ぷりんとばんじゅくセミナー 無料 事前登録不要　セミナー会場F

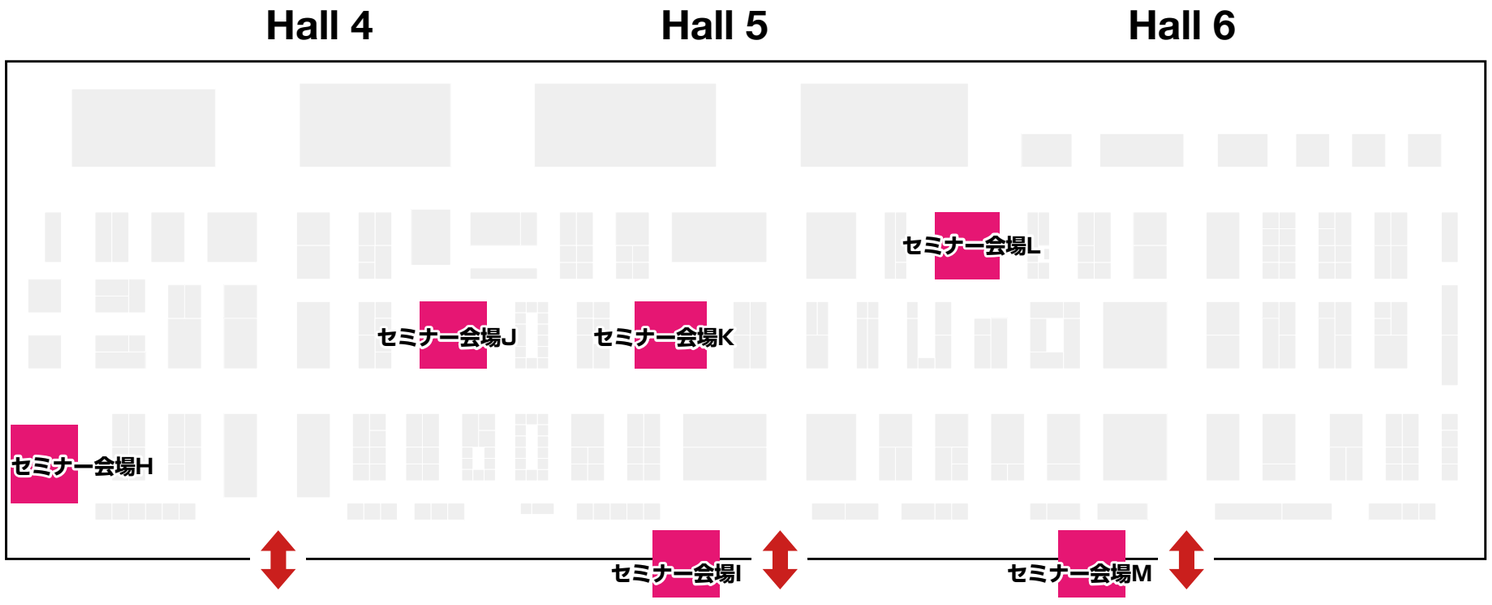
	5月31日（水）
11:00-12:00	プリント配線板全般の基礎“ぷりんとばんじゅくI”をもとに解説 榧場 正男　㈱カヤバオフィス　代表取締役
13:00-14:00	プリント配線板設計の基礎“ぷりんとばんじゅくII”をもとに解説 田中 弘文
14:30-15:30	フレキシブル配線板の基礎“ぷりんとばんじゅくVII”をもとに解説 宮﨑 博明　元MFインフォメーション㈱　代表

	6月2日（金）
11:00-12:00	実装の基礎“ぷりんとばんじゅくV”をもとに解説 榧場 正男　㈱カヤバオフィス　代表取締役
13:00-14:00	品質管理の基礎 安井 博文　安井事務所　PWBコンサルタント

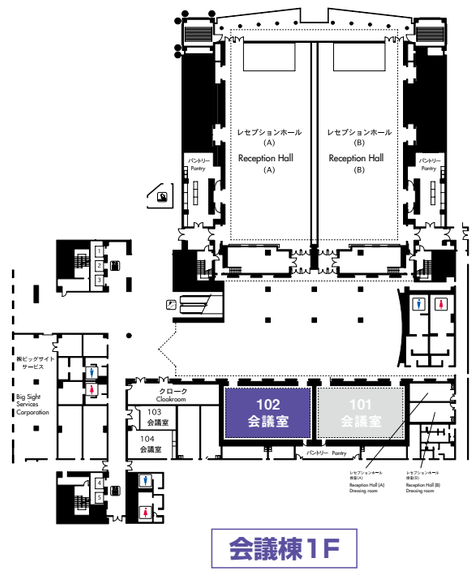
カンファレンスマップ

JPCA Show 2023 第52回国際電子回路産業展 / JIEP マイクロエレクトロニクスショー 第37回 最先端実装技術・パッケージング展 / JISSO PROTEC 2023 第24回 実装プロセステクノロジー展 / SDGsデバイス展 / ～装置と装置をつなぐ～ WIRE Japan Show 電気・光伝送技術展 / Electronics Component & Unit Show JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機部商業協同組合 / E-Textile/Wearable イーテキスタイル／ウェアラブル展 / Smart Sensing スマートセンシング / 無人化ソリューション展 / Edge Computing エッジコンピューティング / interopto インターオプト / Imaging Japan イメージングジャパン

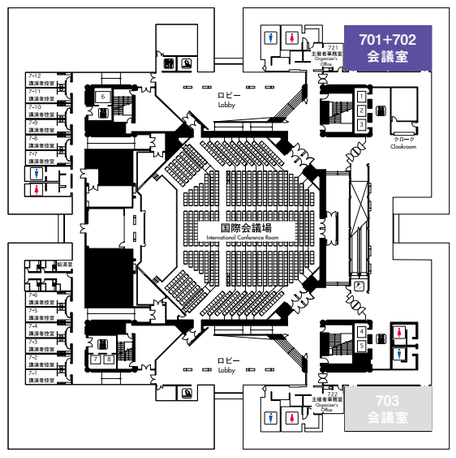
展示ホール内セミナー会場案内図



会議棟セミナー会場案内図



会議棟1F



会議棟7F

JISSO PROTEC特別講演 無料 要事前登録 セミナー会場H

	5月31日（水）	6月1日（木）	6月2日（金）
10:30～11:20	スマートフォン・周辺機器業界見通し 中根 康夫 みずほ証券㈱ エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト	JEITA2022年度版実装技術ロードマップ「注目される市場と電子機器群」～ 脱コロナ・脱炭素を加速する新市場 ～ 西村 隆 JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会 委員長 三菱電機㈱ 先端総合研究所 パワーモジュール技術部 主席研究員	EV時代に対応する接合材料・実装技術 神谷 有弘 ㈱デンソー 半導体基盤技術開発部

Electronics Component & Unit Show特別講演 無料 要事前登録 セミナー会場L

	5月31日（水）	6月1日（木）	6月2日（金）
15:45～16:30	眼鏡フレーム技術を活かしたARグラスの産官学共同開発事例の紹介 芦原 将彰 福井県工業技術センター 機械・金属部 デジタル技術研究G 主任研究員	光導波路型合波器を用いたレーザー走査型映像投影装置の超小型化 中尾 慧 福井大学 産学官連携本部 特命助教	エレクトロニクスの用途拡大～スポーツ分野への応用～ 塚本 淳二 CBC㈱ New Business Department スポーツビジネスユニット プロジェクト・マネージャー

PROTECセミナー 無料 要事前登録 セミナー会場I

5月31日（水）	11:45-12:30	SDGsやカーボンニュートラルにフィットした後工程プロセスの省人化に貢献するディスペンス技術の紹介 新井 武 武蔵エンジニアリング㈱ マーケティング戦略本部 マーケティング戦略部 係長
	12:55-13:40	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2023 若林 利昌 ヤマハ発動機㈱ ロボティクス事業部 営業統括部 SMT営業部 SPグループ
	14:05-14:50	FUJI Smart Factory 2.0の現在地 岩﨑 正隆 ㈱FUJI ロボットソリューション事業本部 ASP PJT プロジェクトリーダー
	15:15-16:00	Autonomous Factoryの実現に向けたエッジ設備の進化 ～NPM Gシリーズ～ 木下 幸児 パナソニック コネクト㈱ プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス事業担当 回路形成プロセス開発総括部 実装プラットフォーム開発部 機構開発1課 マネージャー
6月1日（木）	11:45-12:30	Autonomous Factoryの実現に向けたエッジ設備の進化 ～NPM Gシリーズ～ 木下 幸児 パナソニック コネクト㈱ プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス事業担当 回路形成プロセス開発総括部 実装プラットフォーム開発部 機構開発1課 マネージャー
	12:55-13:40	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2023 若林 利昌 ヤマハ発動機㈱ ロボティクス事業部 営業統括部 SMT営業部 SPグループ
	14:05-14:50	DX時代のスマートな部品管理の秘訣 栗原 可奈乃 JUKI㈱ 営業センター ISMソリューション部 ISM推進グループ
	15:15-16:00	「つながる」社会を支える最新マウンターの技術 水野 貴幸 ㈱FUJI ロボットソリューション事業本部 AIMEXR PJT プロジェクトリーダー
6月2日（金）	11:45-12:30	車載実装から見える実装技術動向と持続的ものづくり 武野 祐丸 ㈱FUJI ロボットソリューション事業本部 営業企画部 マーケティング課
	12:55-13:40	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2023 若林 利昌 ヤマハ発動機㈱ ロボティクス事業部 営業統括部 SMT営業部 SPグループ
	14:05-14:50	Autonomous Factoryの実現に向けたエッジ設備の進化 ～NPM Gシリーズ～ 木下 幸児 パナソニック コネクト㈱ プロセスオートメーション事業部 回路形成プロセス事業担当 回路形成プロセス開発総括部 実装プラットフォーム開発部 機構開発1課 マネージャー
	15:15-16:00	実装変動の知見から生み出される 最先端検査技術と品質システム 杉山 俊幸 オムロン㈱ 検査システム事業部 技術士（経営工学）IntPE（JP）/APECエンジニア

Smart Sensing / 無人化ソリューション展 / Edge Computing セミナー 無料 要事前登録 セミナー会場K

Keynote Speech

	5月31日（水）
10:15-11:05	日本ではあまり語られない、CES2023にみる米国のテクノロジー戦略 青木 崇 ㈱日本政策投資銀行 業務開発部所属 参事役 / 政策研究大学院大学 シニアフェロー 鈴木 和泉 （国研）科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー
14:40-15:30	世界のトレンドからみたメーカーのトレンドとコトへの転換 上野 聡志 MODE, Inc. VP of Business

	6月1日（木）
10:15-11:05	スマートセンシングとインターバース 持丸 正明 （国研）産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長
11:35-12:25	<ピッチステージ>社会実装に進む磁歪振動発電の製品開発と将来展望 北 翔太 金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教 ㈱福田結晶技術研究所 ㈱横山商会 住友金属鉱山㈱

	6月2日（金）
11:35-12:00	構内物流の自動化で実現するオペレーションの効率改善 三村 健二 ㈱マクニカ イノベーション戦略事業本部 スマートシティ＆モビリティ事業部 モビリティソリューション部 プロダクトセールス課 課長
12:00-12:25	ライブデモで実演!!ヒト・モノの移動における無人化を見据えて～モビリティデータ利活用の取り組み～ 上原 拓 ㈱マクニカ イノベーション戦略事業本部 スマートシティ＆モビリティ事業部 DXソリューション部 プロダクトマーケティング第1課

パネルディスカッション

	6月2日（金）
10:15-11:05	においセンサを追求してわかったこと、これから起きること。 モデレーター 吉川 元起 （国研）物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 電気・電子機能分野 嗅覚センサグループ グループリーダー パネリスト 緒方 健治 I-PEX㈱ 取締役 常務執行役員 技術開発統括部長 喜多 純一 ㈱におい科学研究所 代表 今村 岳 ㈱Qception 代表取締役

特別講演

	5月31日（水）
11:35-12:25	製造現場のIoT/DX化を実現するEdgecross 大谷 治之 （一社）Edgecrossコンソーシアム 事務局長

	6月1日（木）
15:45-16:30	Animal DX 藤本 靖 南知床・ヒグマ情報センター 理事長

プレゼンテーション

	5月31日（水）
12:45-13:25	IoTデバイスの電源問題を解決！自立型IoTの社会実装をEnerCeraで実現 田中 立 日本ガイシ㈱ NV推進本部 ビジネスクリエーション グループマネージャー
13:45-14:25	多品種変量時代の戦い方“半導体実装開発に付加価値あり” 安藤 守 コネクテックジャパン㈱ 取締役 常務執行役員
15:45-16:25	エッジヘビーセンシングによる価値創造～集積システムによるエッジセンシングの高度化とその活用～ 室山 真徳 博士（工学） 東北工業大学 工学部 電気電子工学科 教授 / 東北大学大学院工学研究科ロボティクス専攻 客員教授 / ㈱レイセンス 共同創業者・取締役・最高技術責任者

	6月1日（木）
12:45-13:25	マスマーケット向けサーマルセンサーのユースケース拡大 Daniel Jarvis Teledyne FLIR
13:45-14:25	ディスプレイ技術を応用した新しいセンシング技術 仲島 義晴 ㈱ジャパンディスプレイ 執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー
14:45-15:25	セキュアな省電力/長期供給のArm搭載CPUボード/IoTゲートウェイ「Armadillo」 實吉 智裕 ㈱アットマークテクノ 代表取締役

	6月2日（金）
12:45-13:25	自社の取り組みに役立つ企業事例から見る製造業DX 大岡 明 ㈱産業革新研究所 取締役
13:45-14:25	IoT = ニューノーマル 江川 将峰 ディジインターナショナル㈱
14:45-15:25	統合力と総合力による少量多品種の劇的な生産性向上：機械加工業界の先進自動化事例 木本 彰 ファステムズ㈱ アジアセールス パートナーマネージャー
15:45-16:25	日本のデュアルユースロボットの行方 防衛装備庁における研究開発の取り組み 小林 賢一 ロボティック普及促進センター 理事長 / ㈱ロボットメディア 代表取締役 藤井 圭介 防衛装備庁 技術戦略部 技術戦略課長

出展者（NPI）プレゼンテーション 無料 セミナー会場M

5月31日（水）	10:55-11:15	液晶ポリマー（LCP）材料と繊維製品、電子部品への応用 寧波聚嘉新材料科技（JUJIA）
	11:35-11:55	新奇品フレキシブル基板（FPC） 沖電線㈱
	12:15-12:35	あらゆる計測器を同時監視！ソフトウェア開発歴26年の実績で挑む、IoT技術の新たな付加価値。 ㈱ソフトエイジェンシー
	12:55-13:15	A-SAP™向けロープロファイルな触媒付きアルミニウム箔の最新開発状況 東洋アルミニウム㈱
	13:35-13:55	エッジコンピューティングとクラウドの融合 Izuma Networks
	14:15-14:35	高誘電率BTレジン積層材料の紹介 三菱ガス化学㈱
	14:55-15:15	自由自在な多段差配置で大小部品混載一括実装を実現するマルチステップマスク～レーザーステップステンシルの特長と性能～ ㈱ブルックスジャパン
	15:35-15:55	A-SAP™向けロープロファイルな触媒付きアルミニウム箔の最新開発状況 東洋アルミニウム㈱
6月1日（木）	10:15-10:35	A-SAP™向けロープロファイルな触媒付きアルミニウム箔の最新開発状況 東洋アルミニウム㈱
	10:55-11:15	IHリフローで実現する新しいものづくり 低耐熱・高放熱基板上での部品実装を量産まで対応 超低消費電流で、製造工程でのCo2削減、SDGsに貢献 ㈱ワンダーフューチャーコーポレーション
	11:35-11:55	フレキシブル基板+ワイヤハーネス 圓裕企業㈱
	12:15-13:15	パワーデバイス材料の絶縁性能評価技術とUL DAPプログラムとリフローによる試験の対処 ㈱ケミトックス
	13:35-13:55	FC-BGA向け次世代BTレジン積層材料の紹介 三菱ガス化学㈱
	14:15-14:35	マッチ箱サイズの超コンパクトレーザ、MatchBoxシリーズの最新の動向とアプリケーション事例についてご紹介いたします。 フォトテクニカ㈱
	14:55-15:15	プリント基板製造工程用研磨ホイール新商品のご紹介 ≪SR前バフカス詰まり対応研磨ホイール≫ ≪穴埋めインク除去用研磨ホイール≫ 金井重要工業㈱
	15:35-15:55	基板にダメージを与えず微小異物を確実に除去するために～Teknekのクリーニングの科学～ ㈱ブルックスジャパン
	16:15-16:35	DXと新しいデジタルマーケティングの創出 東亜無線電機㈱
6月2日（金）	10:15-10:35	基板分割はレーザーカットの時代へ LPKFレーザーデバネリング（基板分割）最新情報をお届け LPKF Laser & Electronics㈱
	10:55-11:15	ファナックロボットの最新技術 ファナック㈱
	11:35-11:55	微細回路形成用硫酸銅めっきプロセスのご紹介 メルテックス㈱
	12:15-12:35	電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報 ユニオン ツール㈱
	12:55-13:15	分光といえばHORIBA～特注グレーティング&分光・赤外モジュールのカスタマイズ事例～ ㈱堀場製作所
	13:35-13:55	大口径ビア／高速伝送用途／次世代FOWLPおよびFOPLP向け 奥野製薬工業の半導体パッケージ基板用 硫酸銅めっき添加剤 奥野製薬工業㈱
	14:15-15:15	LTspiceをPCB設計に活用する。 （SW電源部のトレースやVIAのインダクタンス成分に注目して） ㈱三共社
	15:35-16:35	地球の未来に配慮した持続可能なめっきビジネス プラメックス㈱

interOpto/Imaging Japan 計測・分析・解析技術セミナー 無料 要事前登録 セミナー会場J

	6月1日（木）
11:15-11:45	カメラを用いた検査システムやセキュリティシステムの設計にも役立つ光学シミュレーション技術 大橋 祐介 サイバネットシステム㈱ デジタルエンジニアリング事業本部 エンジニアリング事業部 オプティカル技術部
11:45-12:15	3D外観検査のためのレーザ構造化照明を実現するDOE技術 川島 勇人 ㈱スペースフォトン 代表取締役

interOpto/Imaging Japan スマートライフ向け光デバイス最新動向セミナー 無料 要事前登録 セミナー会場J

	6月2日（金）
11:10-11:40	最新CMOSプロセス設計技術のスマートライフへの応用可能性 Jan Vermeiren Caeleste CVBA
11:40-12:10	GaInN系赤色LEDの高効率化にむけて 鈴木 敦志 E&E evolution㈱ 代表取締役

interOpto/Imaging Japan スマートファクトリー向けカメラ・センサー・システム最新技術セミナー 無料 要事前登録 セミナー会場J

	6月2日（金）
13:00-13:30	“How Photons Transform Industries”（“光は産業をどう変えるか”） Murali Kumar Luminous Devices（presented by 丸文）Business Line Director, Non-Visible Products
13:30-14:00	可視光波長“外”の画像情報を実利用するには 中村 心哉 Xenics Japan カントリーマネージャ

注目される光技術セミナー 無料 事前登録不要 セミナー会場J

	5月31日（水）
10:35-10:55	<光計測による運動能力計測装置> ～近赤外線LEDとフォトICを並べ、初心者からトップアスリートの運動能力を時間分解能1mSecでリアルタイムに 計測する～ ㈱Stella
10:55-11:15	深紫外線LEDに対する光学部品を用いた最適な光の照射とその応用 ㈱大興製作所
16:10-16:30	視線追跡システムを用いたストレスフリーなコミュニケーション の開発 ㈱オレンジアーチ

	6月1日（木）
16:00-16:20	光パターン形成LED照明「ホロライト・シリーズ」～安心安全・面白い・新しい光の使い方～ パイフォトニクス㈱
16:20-16:40	ドット受光ICが実現する高速・高S/Nセンシング マイクロシグナル㈱

	6月2日（金）
14:50-15:10	人の目のような視覚システムを実現するLiDAR ㈱SteraVision
15:10-15:30	小型、高精度な血液、液体、体液の光学センシング ジーニアルライト㈱
15:30-15:50	安全性を確保し、教育ツールとしても使えるレーザー溶接用電子ゴーグルの開発について 芝原工業㈱

OITDAセミナー「産業の高度化・微細化に貢献する光・レーザ技術」 要事前登録 会議棟1階 102会議室

聴 講 料：一般財団法人光産業技術振興協会賛助会員会社、教育機関、公的機関、報道関係者：無料 一般参加者：¥5,000（消費税・資料代¥1,000含む）
参加申込：光産業技術振興協会ホームページよりご確認ください。 http://www.oitda.or.jp/

	5月31日（水）
10:25-10:30	主催者挨拶 小谷 泰久 （一財）光産業技術振興協会 副理事長兼専務理事
10:30-11:10	レーザー微細加工におけるTACMIコンソーシアムの取り組み 小林 洋平 東京大学 物性研究所附属極限コヒーレント光科学研究センター 教授
11:10-11:50	プリント基板 レーザ加工の現状と未来 金田 充弘 三菱電機㈱ 産業メカトロニクス製作所 レーザ製造部 マイクロ加工機設計課 課長
11:50-12:30	スマートグラス開発の現状と今後の展開 高木 将行 セイコーエプソン㈱ VSMプロジェクト シニアスタッフ
14:00-14:40	マイクロ・ナノフォトニクスの可能性を探る 欧州のエコシステム カルロス・リー European Photonics Industry Consortium（EPIC（EU））Director General
14:40-15:20	AR/VR・自動車産業におけるイメージングとセンシングのトレンド ホセ・ボソ OPTICA（USA） CTO

interOpto/Imaging Japan 次世代通信に向けた光電融合技術セミナー 無料 要事前登録 セミナー会場J

	6月1日（木）
13:00-13:50	Society5.0時代の大容量情報通信を支える光・電波融合デバイス・システム基盤技術 山本 直克 （国研）情報通信研究機構 ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター・副センター長／先端ICTデバイスラボ・ラボ長（兼任）
13:50-14:30	光電融合を支えるハイブリッド光デバイスの開発～光電技術を活用したデバイスにおける信号処理の一部を担うフォトニクスとプラズモニクスを融合したハイブリッド光デバイスの開発～ 岡本 浩行 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授
14:30-15:10	集積光コム光源（マイクロコム）と通信への応用 久世 直也 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 次世代光研究部門 准教授
15:10-15:40	フォトニックサイエンステクノロジ㈱社のファイバー製造技術とファイバ部品開発技術 小林 壮一 フォトニックサイエンステクノロジ㈱ 代表取締役社長

JPCAプリント配線板技術ロードマップセミナー 有料 要事前登録 会議棟7階 701+702会議室

	5月31日（水）
13:00-14:00	2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論 宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ㈱
14:00-15:00	高速通信システム 西尾 俊彦 ㈱SBRテクノロジー
15:00-16:00	高速通信機器用プリント基板 飯長 裕 OKIサーキットテクノロジー㈱
16:00-17:00	多層プリント配線板ロードマップ 戸田 光昭 ㈱メイコー

	6月1日（木）
13:00-14:00	半導体市場動向 山本 義継 みずほ証券㈱
14:00-15:00	半導体パッケージ技術動向 宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ㈱
15:00-16:00	機能集積配線板技術動向 吉村 英明 FICT㈱
16:00-17:00	半導体パッケージ用サブストレート 加藤 功 凸版印刷㈱

テラヘルツテクノロジーフォーラム 第15回テラヘルツビジネスセミナー（THz-biz 2023）～テラヘルツセンシングの応用展開～ 無料 要事前登録 セミナー会場J ※展示会場（要事前登録）＋Zoom配信（ハイブリッド開催）

	5月31日（水）
13:00-13:05	開会あいさつ/プログラム案内 林 伸一郎 テラテクフォーラム（情報通信研究機構） 戦略企画委員長
13:05-13:35	THz（300GHz）対応Beyond5G/6G向けアンテナ計測と空間電波可視化技術 杉山 武史 ㈱フォトニックエッジ 代表取締役
13:35-13:55	テラヘルツ波計測システムとコンポーネント 深澤 亮一 ㈲スペクトルデザイン 代表取締役
13:55-14:25	走査型テラヘルツ波点光源顕微鏡の開発とがん病理診断応用 芹田 和則 大阪大学 経営企画オフィス 准教授
14:25-14:45	Beyond 5Gに向けた材料・デバイスの周波数特性計測システムのご紹介 加藤 英志 ㈱アドバンテスト 新事業推進室 マネージャー
14:45-15:05	300GHzウォークスルーボディースキャナーの開発 大谷 知行 （国研）理化学研究所 チームリーダー
15:05-15:35	テラヘルツ無線技術による身体近位空間の計測と通信 門内 靖明 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 准教授
15:35-15:50	まとめ＋NICTフレームワーク 齋藤 伸吾 情報通信研究機構（テラテクフォーラム） 主任研究員

Electronics Component & Unit Show 出展者セミナー 無料 セミナー会場L

	6月2日（金）
11:20-11:50	DXと新しいデジタルマーケティングの創出 中捨 隆弘 東亜無線電機㈱ ソリューション開発部

interOpto/Imaging Japan企業プレゼンテーション 無料 事前登録不要 セミナー会場J

	5月31日（水）
11:30-11:50	独国APE社製 高性能スキャニングオートコリレータpulseCheckシリーズのご紹介 フォトテクニカ㈱
12:05-12:25	銅炭素複合材料による次世代オプトエレクトロニクスデバイスの放熱設計への展開 UBE㈱

	6月1日（木）
10:30-11:00	同時多波長測定を可能にするポリクロメータ式 光スペアナのご紹介 ㈱島津製作所

車載向けレーザ加工最新動向 無料 要事前登録 セミナー会場L

	6月1日（木）
13:00-13:40	E-mobility時代における自動車部品へのレーザ加工技術適用及び最新技術動向 白井 秀彰 ㈱デンソー 先進プロセス研究部 機能創成研究2室 Project General Manager
13:40-14:20	EVへの適用が広がる高出力ブルーレーザ及び最新半導体レーザ加工 武田 晋 レーザーライン㈱ 代表取締役社長